



## Description

Les boîtiers de protection sont fabriqués sur mesure par photogravure ou par emboutissage de fines feuilles métalliques, qui sont ensuite pliées et soudées ou agrafées pour former un blindage continu. Ils peuvent être munis d'un couvercle amovible ou fixe.

Ces boîtiers sont montés sur une carte à circuits imprimés de façon à recouvrir un seul ou plusieurs composants afin de fournir un excellent blindage EMI.

## Application

Les boîtiers de blindage pour circuits imprimés sont une solution efficace pour l'isolation de composants au niveau de la carte. Ils permettent des blindages individuels ou multicavités sur les composants d'une carte à circuits imprimés.

## Disponibilité

Nous pouvons produire rapidement des boîtiers sur mesure adaptés à des applications particulières et offrir ainsi une solution plus efficace qu'un produit standard.

La photogravure est un processus flexible qui permet de réaliser des produits économiques dans de courts délais.

Les boîtiers peuvent être livrés sous deux formes :

- à plat, avec un pré-marquage pour faciliter leur pliage,
- ou déjà pliés.

L'emboutissage et le poinçonnage sont des processus plus coûteux en raison de l'outillage, mais ils permettent un volume de production élevé avec de faibles coûts unitaires. En revanche, les boîtiers réalisés par ce processus ne peuvent être livrés que sous forme déjà pliée.

- Les boîtiers sont produits avec un couvercle fixe ou amovible permettant l'accès aux composants.
- Les boîtiers peuvent être adaptés pour un montage traversant ou en surface.

- Des séparateurs internes peuvent être ajoutés à la plupart des conceptions.
- Des trous de ventilation et d'accès peuvent être incorporés dans les couvercles et les côtés.
- Les petits boîtiers peuvent être fournis sur rouleau pour un assemblage automatisé.
- Un large choix de matériaux et de finitions est disponible, incluant des métaux non ferreux (phosphore-bronze, cuivre-béryllium) et des finitions étain, nickel et étain/plomb.

## Considérations de conception

La conception la mieux adaptée à une application donnée sera dictée par des facteurs comme la taille, le volume, la technique d'assemblage, l'accessibilité des composants, etc... Cependant, une attention particulière doit être portée au choix du matériau :

- Les applications à basse fréquence (transformateurs, bobines, etc...) nécessitent un matériau à haute perméabilité tel que l'acier ou le fer au nickel.
- Les applications à haute fréquence (microprocesseurs, dispositifs à commutation rapide, alimentations à découpage) nécessitent des matériaux non-ferreux.

## Capacité de production

---

Kemtron dispose d'une grande expérience dans la conception et la fabrication d'une large gamme de produits de blindage électromagnétique, et met ses compétences à votre disposition pour trouver des solutions à vos problèmes de blindage.

## Spécifications

---

Les boîtiers de blindage étant fabriqués sur mesure, merci de contacter notre service commercial pour discuter de vos besoins. Il faudra nous fournir un dessin ou un cahier des charges stipulant les dimensions, les types de matériaux, les configurations, les quantités, les tolérances, l'emballage et tout besoin spécifique.

